

江苏长电科技股份有限公司控股子公司 STATS CHIPPAC PTE. LTD. 涉及仲裁公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：美国仲裁协会旧金山办公室已受理，尚未开庭
- 上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司 STATS CHIPPAC PTE. LTD. 为被申请人。
- 涉案的金额：1,080 万美元及利息、仲裁费、律师费
- 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本案尚未开庭审理，暂无法确定本案对公司本期及期后利润的具体影响。

一、本次仲裁的基本情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）接控股子公司 STATS CHIPPAC PTE. LTD. 通知，Broadcom Corporation、Broadcom Limited，及 Broadcom Singapore Pte. Ltd.（以下合称“博通公司”）就《Semiconductor Packaging Agreement》合同履行争议事项向美国仲裁委员会（American Arbitration Association）旧金山办公室提起仲裁申请，STATS CHIPPAC PTE. LTD. 已于4月23日收到《仲裁通知书》（案件编号 01-19-0001-2223）。

二、仲裁的案件事实与请求内容

（一）仲裁的案件事实

2013年2月，STATS CHIPPAC PTE. LTD. 与博通公司签署了《Semiconductor Packaging Agreement》，合同约定若 STATS CHIPPAC PTE. LTD. 提供的封装制造

产品侵犯第三人专利导致博通公司遭受损失时，STATS CHIPPAC PTE. LTD. 必须赔偿申请人因此所受的损害。

2016 年 5 月，第三人 Tessera Technologies Inc. ,Tessera Inc. 及 Invensas Corp. (以下合称”Tessera”)共同向博通公司提起专利侵权诉讼及其他法律程序(ITC)，之后博通公司与 Tessera 于 2017 年 12 月达成和解协议，由博通公司支付和解金给 Tessera。博通公司认为部分涉及专利侵权的产品系由 STATS CHIPPAC PTE. LTD. 提供，进而向 STATS CHIPPAC PTE. LTD. 要求赔偿其损害。

(二) 仲裁请求内容

1. 请求裁决被申请人向申请人赔偿损失违约损失及利息；
2. 请求裁决被申请人向申请人赔偿损失违约损失产生的利息、律师费、仲裁费及其他仲裁机构授权的费用；
3. 其他仲裁机构认为合适及适当的进一步救济措施。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。

鉴于本案尚未开庭审理，暂无法确定本案对公司本期及期后利润的具体影响。公司将根据本次仲裁的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日